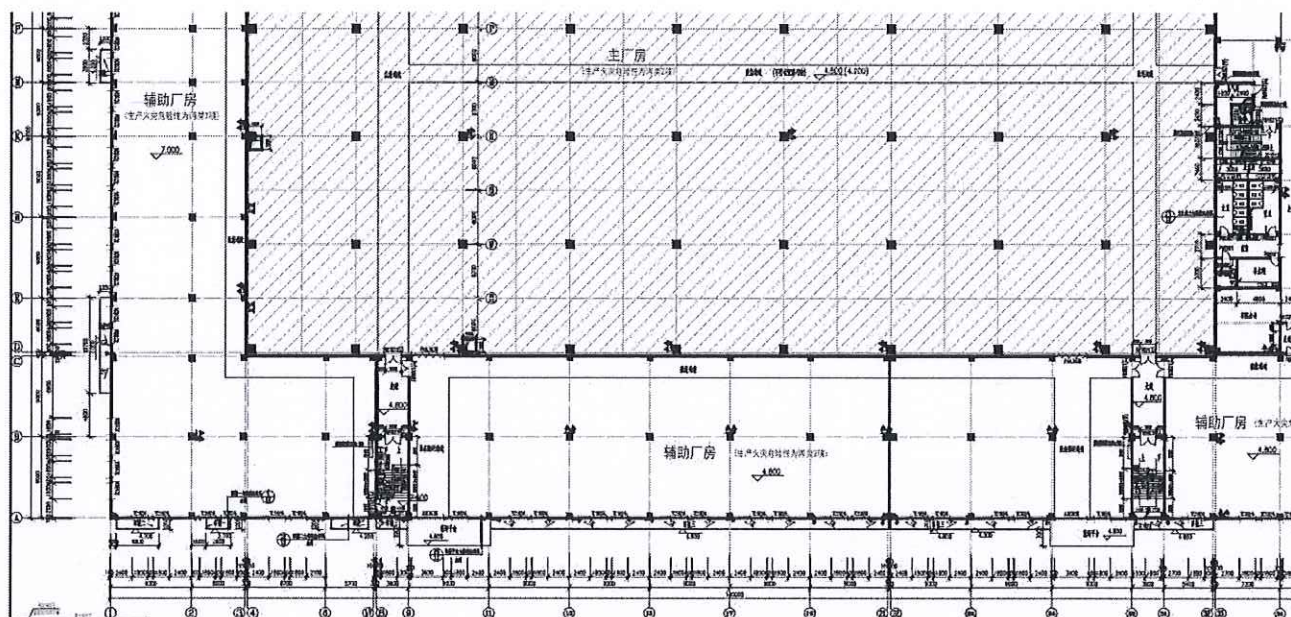


附件 5：福建福顺晶圆科技有限公司 8 英寸集成电路芯片项目局部施工图变更前后图纸
主厂房二层：4-33 轴交 M-P 轴新增隔墙修改前：



主厂房二层：4-33 轴交 M-P 轴新增隔墙修改后：

